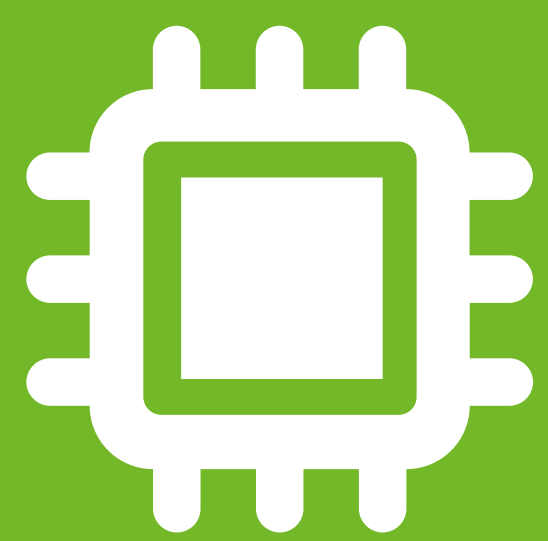




半導体・電子デバイス ソリューション

ウェーハから実装品までの 電子デバイス品質管理に対応

プロセス

アプリケーション

製品

ウェーハ

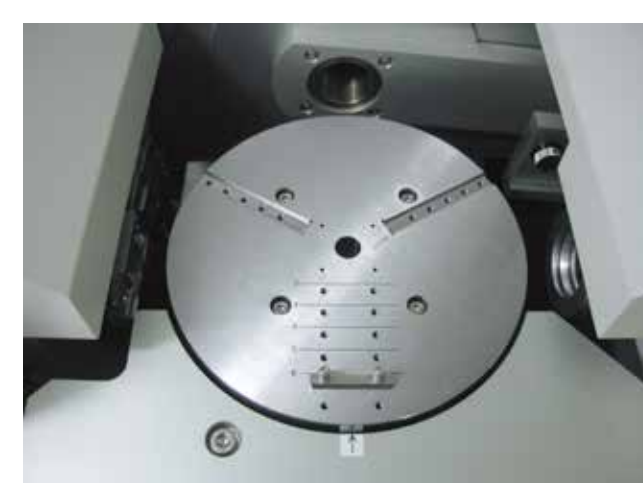


結晶方位検査

インゴット・ウェーハ



インゴット端面測定(φ2インチ)の場合



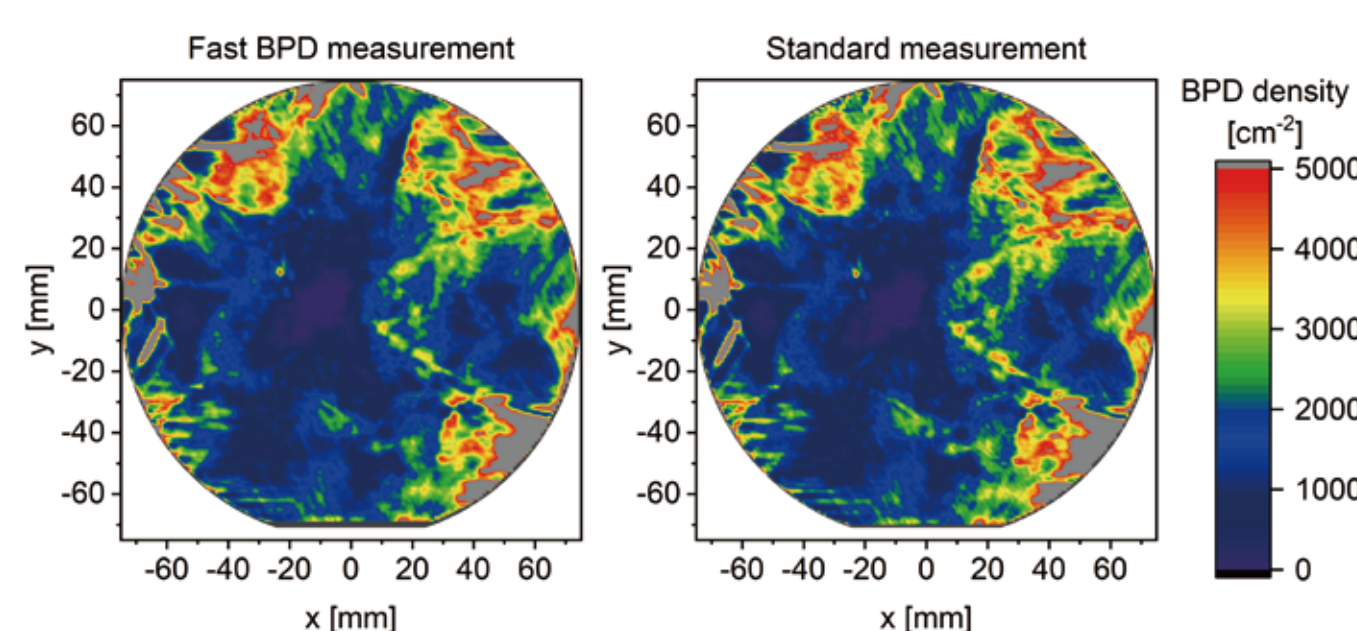
標準試料台



FSAS III

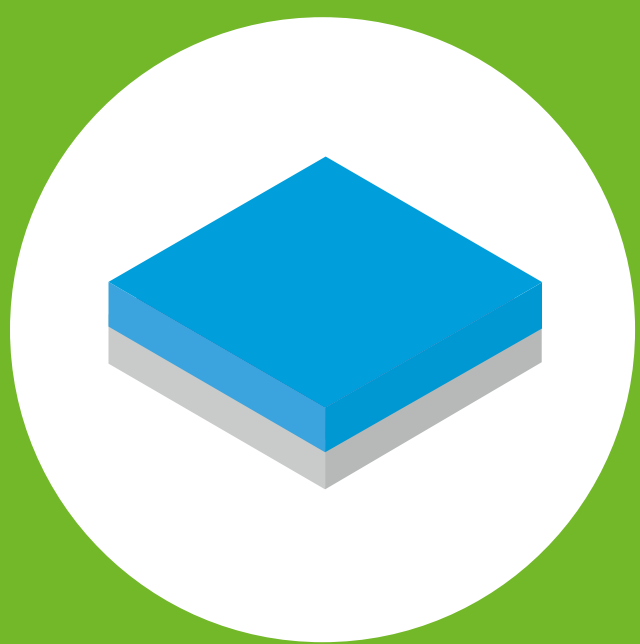
結晶欠陥解析

単結晶基板



XRTmicron

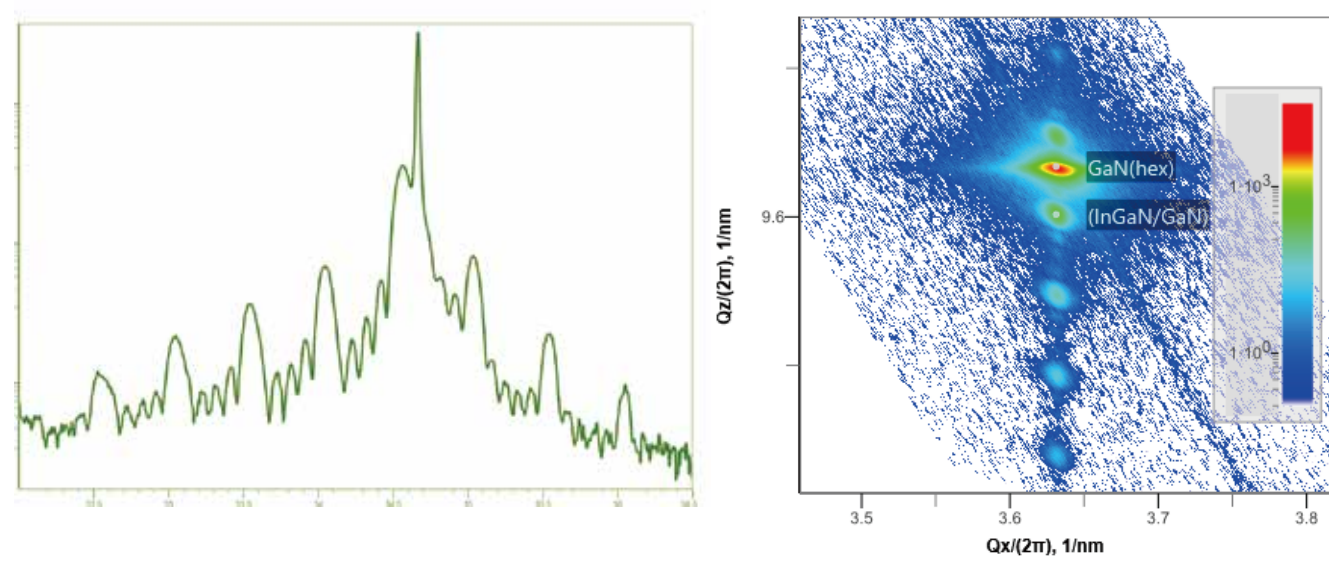
成膜・電極成型



成膜評価

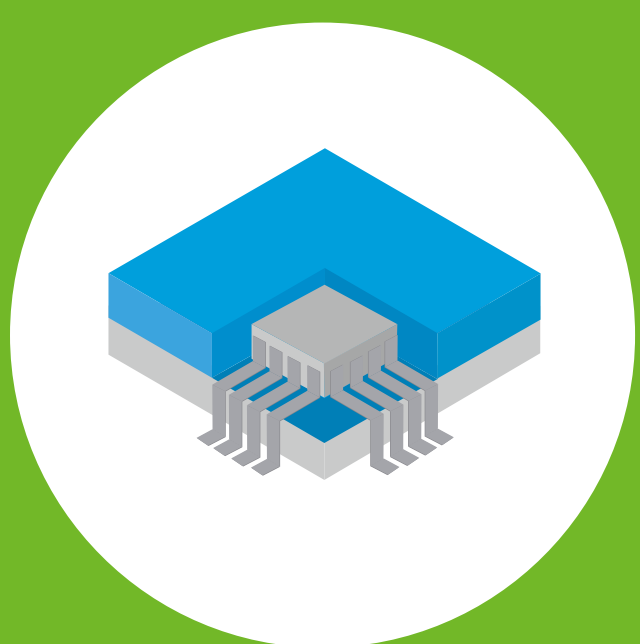
薄膜材料

(~12 inch)



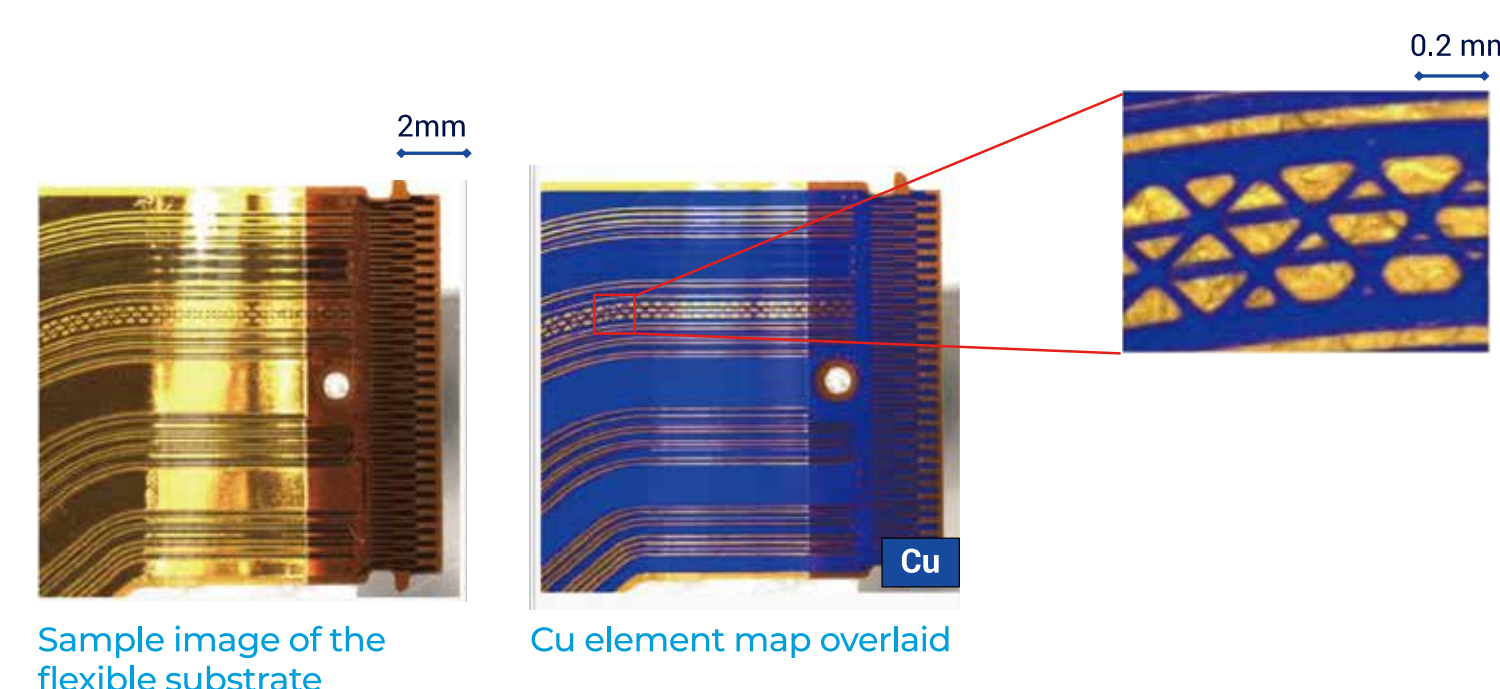
TFXRD-300

パッケージ・実装



元素マッピング

電子部品



Sample image of the flexible substrate

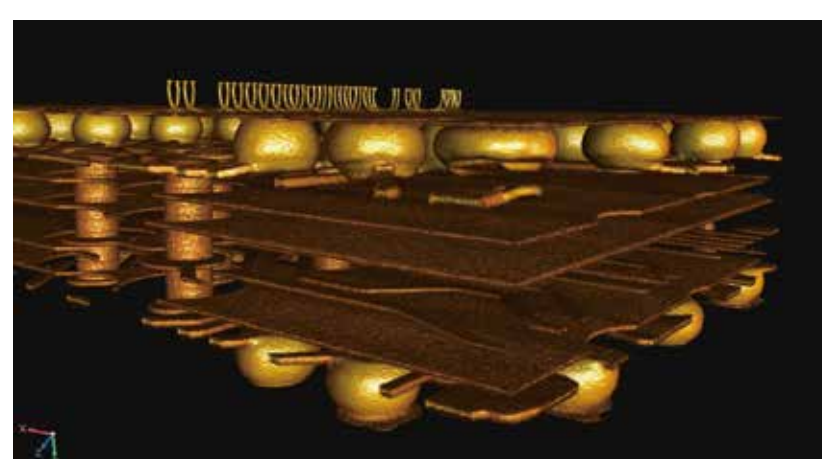
Cu element map overlaid



Qualana

内部構造観察

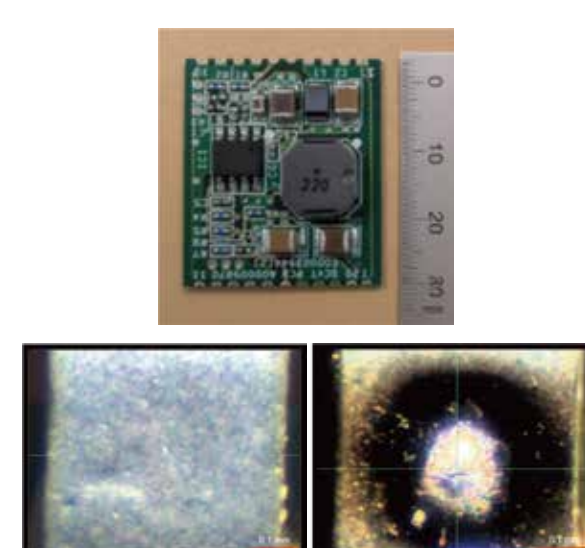
電子部品



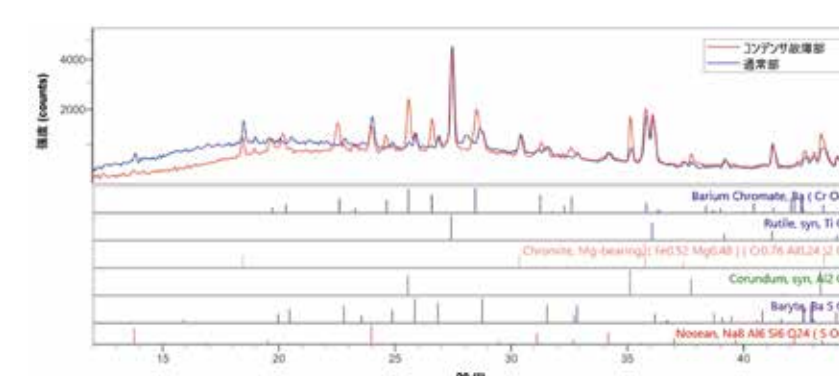
CT LAB HRI60

応力測定

電子部品



基板上的電子部品の定性分析



DicifferX
Microarea Edition